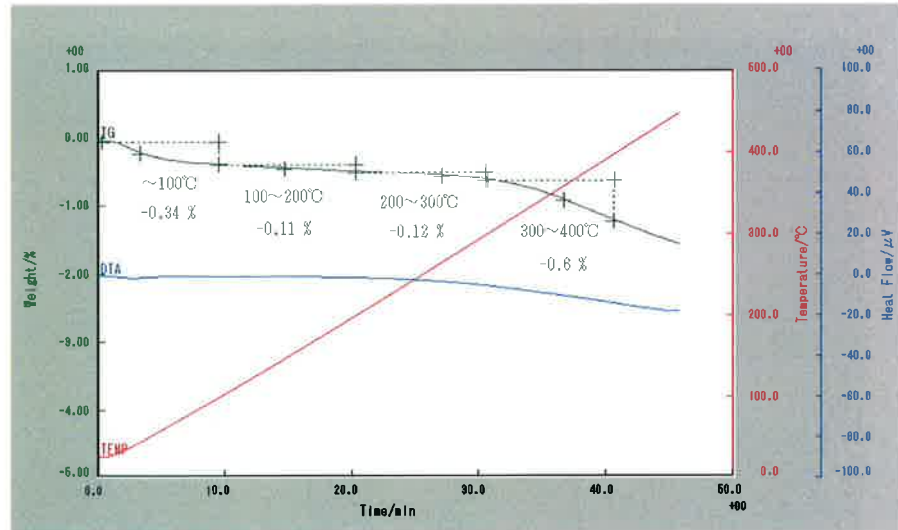
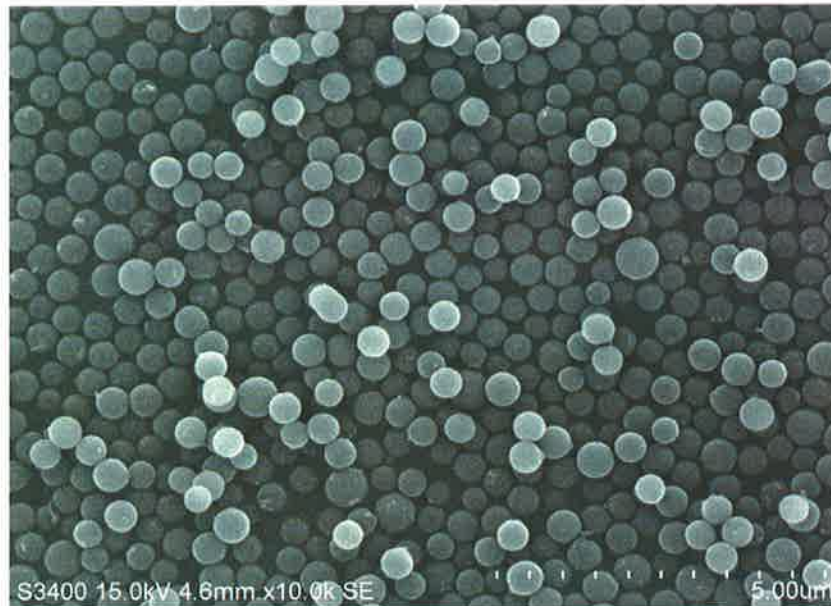


球状シリコンパウダー “MSP-SN05, SN08”



MSP-SN05 TG-DTA

製品名	MSP-SN05	MSP-SN08
外観	白色粉末	白色粉末
平均粒子径(μm)	0.5	0.8

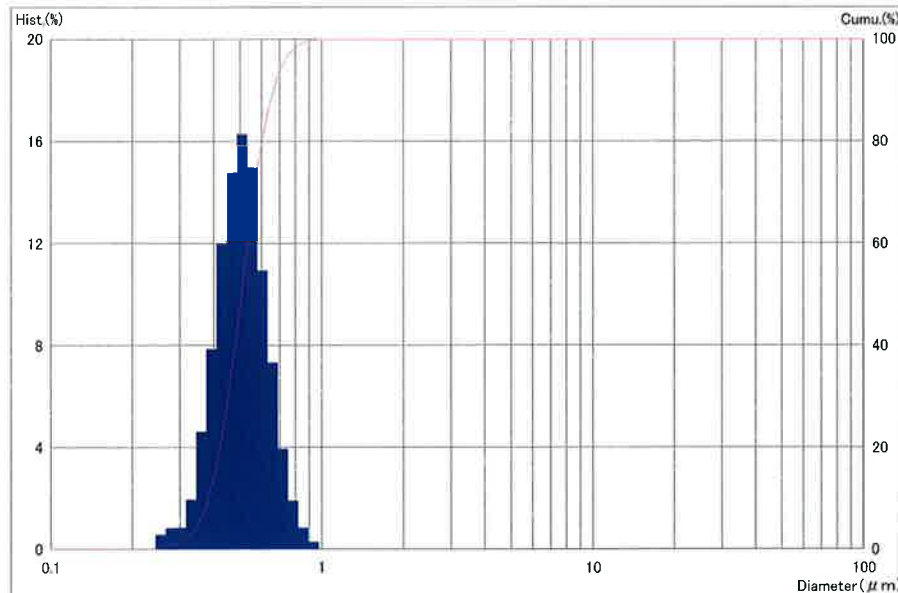
(規格値ではありません)

☆特徴

- ・他の有機系微粒子に比べ耐熱性に優れている。
- ・耐候性、耐酸性に優れ有機溶剤にも不溶。
- ・絶縁性に優れている。

☆用途

- ・液状封止材、アンダーフィル(熱応力緩和)
- ・インキ用途(タックフリー)



MSP-SN05 粒度分布

お問い合わせ先: 日興リカ株式会社 新事業推進本部 担当: 水嶋

TEL: 03-5209-9866(直通) FAX: 03-5209-9874 E-mail: tmizushima@nikko-rica.co.jp